

レゾナック、シリコンバレーに半導体後工程の R&D 拠点を新設予定

～ GAFAM や米国半導体メーカーが集う地で最先端の技術開発を推進 ～

株式会社レゾナック（社長：高橋秀仁、以下 当社）は、米国カリフォルニア州のシリコンバレーに半導体のパッケージング及び材料の研究開発センターの開設を予定し、導入設備などの調査、準備を開始しました。

半導体市場は 2030 年には 1 兆ドル規模を超えるとも予想されるなか、今年から急拡大を続ける生成 AI をはじめとした AI 技術の進化は加速する一方です。それを支える最先端の半導体技術の多くは、Intel や nVIDIA といった米国半導体メーカーが集積するシリコンバレーから生まれています。さらに、近年では生成 AI サービスを含めクラウドサービスを展開する GAFAM*に代表される大規模クラウドサービスプロバイダーが自社のサービスに最適化した AI 半導体を自身で開発していることが知られています。

今回、当社はその半導体技術のコンセプトリーダーが集うシリコンバレーに、半導体の先端パッケージ材料技術の研究開発センターであるパッケージングソリューションセンター（PSC）を新設する準備を始めました。PSC は日本国内では新川崎で実績があり、300mm ウェハや 500mm 角パネルに対応する、レーザーダイシングや微細配線形成が可能な最新鋭の設備等を備え、2.xD や 3D 半導体パッケージなどの最先端プロセス・材料に関する試作・評価を一貫して行うことができる拠点として、世界的な半導体メーカーからの注目を集めています。今年は上半期までに世界 150 社からの訪問がありました。こうした活動をより広げていくため、米国への拠点開設を決めました。AI 向け半導体をはじめとした最先端半導体のパッケージング技術の最新コンセプト、及びトレンドをリアルタイムに捉え、材料開発に反映させていく計画です。

現在、導入設備の調査検討、及び準備を進めており、今後クリーンルーム、設備を導入後、2025 年度の運用開始を予定しています。

* GAFAM : Google・Apple・Facebook・Amazon・Microsoft の略

以上

【Resonac（レゾナック）グループについて】

レゾナックグループは、2023年1月に昭和電工グループと昭和電工マテリアルズグループ（旧日立化成グループ）が統合してできた新会社です。

半導体・電子材料の売上高は、全体の3割にあたる約4,000億円に上り、特に半導体の「後工程」材料では世界No.1の企業です。2社統合により、材料の機能設計はもちろん、自社内で原料にまでさかのぼって開発を進めています。新社名の「Resonac」は、英語の「RESONATE：共鳴する・響き渡る」と、Chemistryの「C」の組み合わせです。今後さらに共創プラットフォームを生かし、国内外の半導体メーカー、材料・装置メーカーとともに技術革新を加速させます。詳しくはウェブサイトをご覧ください。

株式会社レゾナック・ホールディングス <https://www.resonac.com/jp/>

◆ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社レゾナック・ホールディングス

ブランド・コミュニケーション部 広報グループ

TEL 03-6263-8002